

Porta Wafers De Ptfе Personalizado Cesto Floral Resistente Químico Com Design De Alça Para Limpeza De Semicondutores

Número do item: PL-CP166



introdução

Maximize o rendimento de semicondutores com porta wafers de PTFE personalizados e cestos florais. Projetados para resistência superior ao ácido fluorídrico e reagentes agressivos, esses sistemas de manuseio de alta pureza possuem alças ergonômicas e ranhuras usinadas com precisão CNC para limpeza de processo úmido segura e livre de contaminação.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Processos de Limpeza RCA	Limpeza sequencial usando soluções SC-1 e SC-2 para remover resíduos orgânicos e contaminantes metálicos.	Resiste a alto pH e estresse oxidativo sem lixiviar impurezas no banho.
Corrosão com Ácido Fluorídrico	Remoção de camadas de óxido nativo ou camadas de vidro sacrificial de wafers de silício usando HF concentrado.	Resistência completa ao HF, que de outra forma dissolveria o vidro ou degradaria plásticos padrão.
Corrosão / Remoção Piranha	Remoção de contaminação orgânica pesada ou fotorresiste usando uma mistura de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio.	Mantém a integridade estrutural nas altas temperaturas exotérmicas geradas pelas soluções Piranha.
Revelação para Fotolitografia	Imersão de wafers em soluções reveladoras para definir padrões de circuito após exposição UV.	Ranhuras de precisão garantem exposição uniforme da superfície do wafer ao fluido revelador.
Enxágue Pós-CMP	Enxágue de alta pureza após Polimento Químico-Mecânico para remover partículas de pasta de polimento.	Superfície antiaderente impede o acúmulo de pasta e facilita a descontaminação rápida e completa.
Fabricação de Semicondutores Compostos	Processamento de wafers de GaAs, InP ou SiC para fabricação de eletrônica de alta frequência e LEDs.	Características de manuseio suave evitam a fratura de materiais compostos mais frágeis.
Limpeza Ultrasônica / Megasônica	Suporte a wafers durante a limpeza acústica de alta frequência para desalojar partículas submicrônicas.	Excelente amortecimento de vibração e estabilidade química sob forças de cavitação acústica.

Categoria de Especificação	Detalhes do Parâmetro para PL-CP166	Opções de Personalização
Material Principal	PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)	PFA opcional para maior transparência/pureza
Compatibilidade com Tamanho de Wafer	4 polegadas (100mm), 6 polegadas (150mm), 8 polegadas (200mm)	Diâmetros personalizados e formatos não padrão disponíveis
Configuração de Ranhuras	Perfis de ranhura em V ou ranhura em U cortados com precisão	Passo, profundidade e espaçamento angular de ranhura personalizados
Capacidade	Configurações padrão para 25 ou 50 wafers	Tamanhos de lote sob medida de wafer único até alto volume
Design da Alça	Alças integradas de montagem superior ou lateral	Alças removíveis, estendidas ou compatíveis com automação
Resistência Química	Espectro completo (Ácidos, Bases, Solventes, Oxidantes)	Verificado para HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH, etc.
Temperatura de Operação	-200°C a +260°C	Adaptado para perfis específicos de ciclagem térmica
Método de Fabricação	Usinagem CNC Personalizada de ponta a ponta	Controle de tolerância de precisão para interface automatizada
Protocolo de Limpeza	Lavado em sala limpa e embalado a vácuo	Pré-limpeza especializada para análise de traços